

低温锡膏 锡膏 易弘顺电子

产品名称	低温锡膏 锡膏 易弘顺电子
公司名称	苏州易弘顺电子材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山开发区新都银座3号楼1502室
联系电话	18094330000 18094330000

产品详情

无铅焊膏中的锡粉（粉末指微球）占88-90%（重量），必须倒圆成球形，以便于印刷时的滑动。由于硬度柔软且易于粉碎，因此混合时要小心。目前的无铅焊膏主要基于日本SAC305（欧洲SAC3807，或美国SAC405等），日本版本有SZB83和SCN。至于AIM的焊膏CASTIN（Sn2.5Ag0.8Cu0.5Sb）四元合金在亚太地区很少见。本公司的产品有，无铅焊锡膏，铅锡膏，高温锡膏，低温锡膏，高银锡膏，低银锡膏，阿尔法锡膏等，欢迎来电咨询。

将焊膏管理返回冰箱后，使用焊膏离开冰箱后，必须将其置于干燥的室温环境中4-6小时才能达到内外温度才能打开。不要被容器外观不冷的事实所迷惑。在打开之前必须在内部和外部完全加热。当焊膏的总温度低于室内的露0点时，焊膏的外观会使空气中的水凝结并将其附着在水滴上。所谓的露0点意味着空气中的温度将继续增加，空气中的水分将继续增加，直至其饱和（100%RH），相应的温度称为“露0点”。从冰箱中取出的空杯很快就会附着水滴。这就是原因。此外，低温锡膏，焊膏不应该快速回温以防止焊剂或其他有机物分离。在打开开口之前已经加热的焊膏，并且将瓶子放置在结合旋转和旋转的混合器中，并且周期性地旋转容器的不同位置以实现使内部焊膏均匀化的目的。为了正确打开焊膏，锡膏，使用小的压力件在固定方向上轻轻搅拌约1-3分钟，有铅锡膏，以使整体分布更均匀。不应强烈和过度搅拌以避免损坏焊膏和剪切应力（ShearForce）。该方面的弱化可能导致崩塌（坍塌）甚至焊后桥接的发生。

焊膏的管理3.1冷藏储存焊膏由锡合金圆球和半体积的有机赋形剂制成，均匀混合。然而，由于两者之间的差异很大，长时间放置后不可避免地会出现分离和沉淀现象，当储存温度高时分离现象会恶化，甚至更容易发生氧化现象。发生，印刷和流动。变性甚至可焊性都会产生不利影响。因此，它只能存放在冰箱（5-7°C），以确保其使用和寿命。3.2干燥环境锡膏易吸水（吸湿），一旦吸入水分，其特性会大大降低，在后续操作中不可避免地会产生许多麻烦（如焊球），所以相对湿度在现场印刷环境不能超过50%。温度范围应保持在22-25°C，并应完全避免，以减少干燥的发生。否则，它很容易失去印刷并导致焊膏氧化，这也会消除除锈功能中助焊剂的能量，这可能导致足部表面和表面的除锈能力不足。垫，甚

至可能导致崩溃和桥接。焊球和粘着时间 (TackTime) 也缩短了。

低温锡膏-锡膏-易弘顺电子(查看)由苏州易弘顺电子材料有限公司提供。苏州易弘顺电子材料有限公司 (ucohesion.com) 在电子、电工产品制造设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，易弘顺电子一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：沈先生。